

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司

2021 年 05 月 19 日投资者关系活动记录表

编号：2021-006

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	明达资产、吴丽莎、张永清、聂亚长、陈凯鸿、张意文
时间	2021 年 05 月 19 日
地点	公司本部商务会议室
上市公司 接待人员姓名	公司董秘李丽杰、公司财务部高级总监彭秧、沛顿科技副总经理张国、公司董办证券事务研究员刘玉婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	本次会议主要介绍了公司的发展战略，核心竞争优势，产品与业务、公司情况，以及未来发展方向，并就调研投资者关心的合肥项目及配套募集资金情况等有关问题进行了解答。 一、公司基本情况介绍 公司成立于1985年，经过三十六年的发展，是全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，在电子产品制造领域拥有逾三十年的技术沉淀和工程制造经验积累，有完善的精细化管理体系，有国际化的管理团队和海外网络，是业内国际化大客户的核心供应商和战略合作伙伴，规模优势及资源优势明显。产品主要应用于计算机、网络通讯消费电子、智能移动终端、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能领域。目前形成聚焦发展半导体封测及模组、高端制造、自有品牌（以计量产品为主）三大产业领域的发展模式。深科技未来将面向国内国际两个市场形成相互促进的新格局，着力打造国内国际竞争新优势，以国际化视野，围绕大客户发

	展方向和需求强化海内外研发、生产、制造的联动布局。 二、交流环节 1、经营业绩情况如何？ 答：2020年度，公司聚焦全球的行业龙头客户资源优势，加大国内外市场开拓力度，携手战略合作伙伴在合肥投资建厂扩充产能；利用自主研发创新优势，持续开拓计量系统产品的全球业务版图；聚集高端制造规模化制造和跨区域布局优势，配合医疗器械客户完成强劲的订单需求，并积极寻求新能源汽车电子、智能产品、数据存储、新能源等新兴行业成长机会，不断深化与国内外优质客户的合作。公司主营业务收入逆势增长，实现营业收入149.67亿元，同比增长13.18%；归属于上市公司股东的净利润8.57亿元，同比增长143.30%。 2、公司未来发展战略如何？ 答：深科技是全球领先的EMS专业提供商，在电子产品制造领域拥有逾三十年的技术沉淀和工程制造经验积累，有完善的精细化管理体系，有国际化的管理团队和海外网络，是业内国际化大客户的核心供应商和战略合作伙伴，规模优势及资源优势明显。目前形成聚焦发展半导体封测及模组、高端制造、自有品牌（以计量产品为主）三大产业领域的发展模式。深科技未来将面向国内国际两个市场形成相互促进的新格局，着力打造国内国际竞争新优势，以国际化视野，围绕大客户发展方向和需求强化海内外研发、生产、制造的联动布局。 3、合肥半导体投资项目情况？ 答：深科技顺应国家半导体战略，助力国内存储器厂的快速发展。合肥沛顿存储注册资本30.60亿元，深科技全资子公司沛顿科技、大基金二期、合肥经开投创和中电聚芯分别出资17.10亿元、9.50亿元、3亿元和1亿元，依次持股55.88%、31.05%、9.8%、3.27%，深科技拥有绝对控股权。本项目实施后，可满足客户较大需求的DRAM、Flash存储芯片封测以及DRAM内存模组制造业务，有助于国内存储器芯片封测的深度国产化，提升国产存储芯片封测的产业规模，促进我国存储器产业链发展。 4、问：沛顿今年和未来如何满足客户产能需求？
--	---

	答：目前客户业务主要集中在深圳园区生产，公司随着客户产能提升公司已进行相应的厂房扩建和设备投资，以满足客户产能快速提升的需求，未来相关项目建成后，将可满足国内外市场高性能存储芯片未来发展及客户新增产能持续扩张需求，进而打造公司集成电路半导体业务的长远竞争力。 5、问：深科技沛顿在封测方面是否掌握核心技术？ 答：深科技8Gb/16Gb DDR4已于2019年通过了国内外多个大客户的验证正式交付，目前公司在存储封测17nm量产基础上，持续推进更精密10nm级DRAM产品的技术迭代，不断向全球DRAM市场的主流工艺节点技术进行突破。深科技目前的封测技术能够覆盖主流存储器产品，并具备LPDDR3、LPDDR4和固态硬盘SSD的量产能力。同时，在国内外存储芯片向高速、低功耗、大容量发展的行业趋势下，深科技不断推动DDR5、LPDDR5等新产品的技术开发，且具备最新一代DRAM产品的封测能力。 6、公司本次募资情况进展如何？ 答：5月18日晚，公司披露了非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，公司成功向17名投资者非公开发行8932.82万股，募集资金总额14.74亿元。本次发行募集资金投资项目主要围绕公司发展战略布局展开，未来公司将进一步增强在存储芯片封装测试及模组制造领域的生产能力，提升公司的核心竞争力。 7、项目发行价格是多少？ 答：本次发行价16.50元/股较T日（2021年4月21日）收盘价18.51元/股的折扣率为89.14%，2021年以来，二级市场出现大幅回调，尤其半导体、消费电子行业承压严重，公司在募投项目规模较大、大盘大幅回调、行业走势承压的大环境下，取得今年同行业公司中最高的折扣率89.14%，展示出企业良好的基本面及较强的资本市场影响力。 8、募资项目机构参投情况如何？ 答：本次非公开发行共24名投资者参与询价申购，累计认购量21.08亿元，认购倍数达1.43倍，发行对象最终确定为17名投资者。其中包括地方国资的代表，如广东省国资体系的广东恒阔投资管理有限公司、广东恒
--	--

	坤发展投资基金有限公司和广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)，还有合肥国资体系的合肥市创新科技风险投资有限公司和合肥恒创智能科技有限公司。其中广东省国资体系的三家公司共获配金额近5.4亿元，中金获配1.9亿元，合肥国资的两家公司获配1亿元。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 05 月 19 日